



113 年度工研院電光系統所

平面顯示、系統晶片與半導體構裝技術等相關研發成果讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強而有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含 11 案 22 件專利（以下簡稱：「讓與標的」）。

「讓與標的」共分為：

（一）平面顯示器：5 案 9 件；

（二）系統晶片技術：4 案 8 件；

（三）半導體構裝與熱電技術運用：2 案 5 件。

「讓與標的」含共有專利，並已預先取得共有人之同意。「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

（一）公開說明會將於民國（下同）113 年 5 月 7 日 14 時舉辦。採取線上方式辦理。

（二）公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 113 年 5 月 6 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「113 年度工研院電光系統所平面顯示、系統晶片與半導體構裝技術等相關研發成果讓與案：公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 113 年 5 月 6 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會議資訊。

（三）自本讓與案公告日起至截標日 113 年 5 月 15 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

(一) 本讓與案採通訊或親送方式投標。

投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同：

1. (密封) 價格封。
2. 押標金。
3. 公司設立證明文件 (如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本)。
4. 近兩年財報資料。(如新創公司成立未滿兩年，請檢附成立迄今之財報資料。)
5. 公司基本資料暨運用規劃說明表。
6. 商業營運計畫書一式 7 份。(若投標多案，廠商之商業營運計畫書得僅檢附一式 7 份，惟須於商業營運計畫書中敘明不同之標的運用規劃模式。)

(前述全部資料文件等，以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「113 年度工研院電光系統所平面顯示、系統晶片與半導體構裝技術等相關研發成果讓與案投標」，於截標日 113 年 5 月 15 日 17 時整 (含) 前 (以送達收據為憑) 掛號寄達或親送至：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

工研院技轉法律中心 黃小姐收。

(二) 廠商若有境外實施需求，請於公司基本資料暨運用規劃表及商業營運計畫書中詳細敘明，並於公司基本資料暨運用規劃表敘明境外實施金額。

(三) 商業營運計畫書內容應包含以下事項：

1. 公司背景／關係企業／合作夥伴簡介 (20%)
2. 公司財務狀況 (20%)
3. 公司營運／研發能力 (20%)
4. 「讓與標的」運用規劃 (30%)
5. 國內產業效益 (10%)

(如：對於提升技術之貢獻、與工研院研發合作規劃等)

(四) 投標方式：本讓與案採一案一標，即同一案專利不分開投標／開標。

(「讓與標的」以同一發明為一案。)

(五) 本讓與案不得共同投標或重複投標。

(六) 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。

(七) 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

- (一) 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。

於決標當日依第八條第(六)項約定加價後得標者，應於決標次日起10個工作日內補足押標金。若未於期限內補足者，工研院得沒收押標金並取消得標資格，但經工研院同意者，不在此限。

- (二) 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
- (三) 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於決標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

- (一) 投標時間截止後之投標。
- (二) 開標前業已公告停止本讓與案交易程序。
- (三) 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
- (四) 投標單附加任何成交條件者。
- (五) 「投標文件」之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
- (六) 「投標文件」有所缺漏者。但押標金不足或商業營運計畫書份數不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於複審前未能補足者，其投標為無效。
- (七) 投標廠商或其後手曾將工研院之研發成果(包括但不限於科專成果、自有成果、能專成果)轉讓至陸、港、澳地區者；但前述轉讓行為係經經濟部及／或工研院同意者，不在此限。
- (八) 投標廠商曾與工研院簽約，而發生違約情事者。

八、決標方式：

- (一) 分為初審(113年5月22日)及複審(113年5月29日)，投標廠商於通過初審後，始能進入複審。工研院會另行通知通過初審之投標廠商依通知時間進行複審。
- (二) 得標與否由工研院開標審議委員會會議決定之。
- (三) 初審時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、公司基本資料暨運用規劃說明表、商業營運計畫書等進行形式審查及確認。
- (四) 投標廠商通過初審者，由工研院開標審議委員會會議就商業營運計畫書、價格等進行複審，投標廠商於複審時應蒞會就商業營運計畫書進行簡報說明及答詢，並應自行備妥簡報電子檔等相關文件。
- (五) 投標廠商若有境外實施需求，除應依「五、投標方法」第(二)點敘明外，並應於複審時報告說明。
- (六) 複審時，工研院開標審議委員會會議將同時開啟超過及格分之所有投標廠商價格封，將以投標金額最高且高於底價者得標。若有二(含)

家以上投標廠商出價且皆無超過底價，則出價金額最高之廠商有一次優先加價機會，若此優先加價仍無超過底價，之後則由超過及格分之所有投標廠商同時議價，議價次數以三次為限，由金額最高且高於底價者得標。若有二（含）家以上超過及格分之投標廠商之投標金額均超過底價且相同，得提供該投標廠商議價機會，並以高價者得標。議價次數以三次為限，經三次議價後之投標金額仍相同者，由工研院現場抽籤決定之。（議價時，若非投標廠商負責人出席，須填妥並提供委託代理授權書）

- （七）開標時將請律師到場監標。
- （八）開標結果依政府法令相關規定，須向主管機關呈報者，則於主管機關同意後始生效力。
- （九）工研院將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
- （十）對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。

九、契約事項：

- （一）得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作日內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
- （二）得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。
- （三）得標廠商與工研院簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為。前述逕洽案件須經工研院審議委員會審查通過，方得簽約。
- （四）遵守政府法令規定：得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
- （五）得標廠商應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
- （六）得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本讓與案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。「讓與契約書」生效日：「讓與契約

書」經雙方依法簽章報經濟部及共有人同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部及共有人之意見並無影響能力。

- (七) 反授權約定：得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予經濟部及/或工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」全部或一部專屬授權或讓與第三人（以下簡稱「後手」）時，並應使「後手」同意本條約定。「後手」再為專屬授權或讓與時亦同。
- (八) 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：
1. 工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；
 2. 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；
 3. 工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。
- (九) 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本讓與案公告日之「讓與標的」現狀辦理本讓與案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
- (十) 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
- (十一) 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之政府

法令規定，配合工研院向主管機關（包含但不限於經濟部技術處，以下同）為一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提提供工研院，且應依工研院要求提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及／或主管機關核准及同意後始得為之：

- 1.得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
- 2.得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
- 3.得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
- 4.得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

（十二）得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

- 1.得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
- 2.得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
- 3.為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。

（十三）得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與「後手」時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及／或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前書面通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。此外，若得標廠商違反「九、契約事項」任一條款或讓與或轉讓與「讓與標的」予非專利實施實體（Non-Practicing Entity，以下簡稱「NPE」），或未經工研院及／或經濟部同意之受讓者（以下簡稱「未經同意之受讓者」），造成第三人遭受侵權警告或涉訟時，工研院有權逕行將「讓與標的」非專屬授權予第三人自「讓與契約書」生效日起實施，並保有相關之收益，且已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，經濟部及／或工研院亦無須負擔損害賠償責任。得標廠商應將本約定載明於與「後手」之讓與契約，否則即視為得標廠商已將「讓與標的」讓與予「NPE」或「未經同意之受讓者」，工研院得依前述約定行使相關權利。

（十四）得標廠商應使所有「後手」遵守本條第七項至第九項、第十一項至

第十六項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

(十五) 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院並取得書面同意。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

(十六) 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

(十七) 得標廠商應盡力進行產品開發等運用「讓與標的」工作，倘得標廠商未能舉證於合理期間內有運用「讓與標的」，工研院得以書面解除「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權第三人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院技轉法律中心聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：

本讓與案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本讓與案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本讓與案公告相關問題請洽詢：

工研院技轉法律中心 黃小姐。

電話：(03) 591-3935。

傳真：(03) 582-0466。

電子信箱：ycmhuang@itri.org.tw。

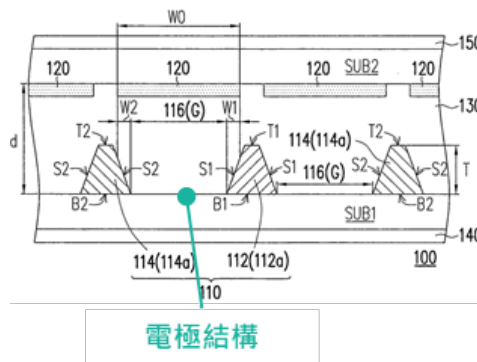
地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室。

附件一：部分讓與標的簡介

■ 平面顯示器

P61010007 液晶顯示面板：

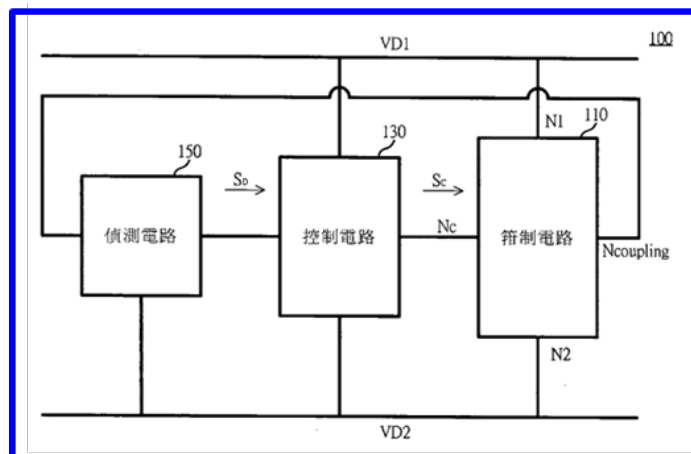
一種液晶顯示面板，其包括第一基板、多個畫素、第二基板、多個浮置電極以及液晶層。畫素係陣列排列於第一基板上，各個畫素包括第一電極以及第二電極，且第一電極與第二電極之間維持一間隙。浮置電極配置於第二基板上，並且位於間隙上方。液晶層位於第一基板與第二基板之間，當第一電極與第二電極之間無電壓差時，液晶層為光學等向性，當第一電極與第二電極之間具有電壓差時，液晶層為光學異向性。



■ 系統晶片技術

P52000091 靜電放電保護裝置及其方法：

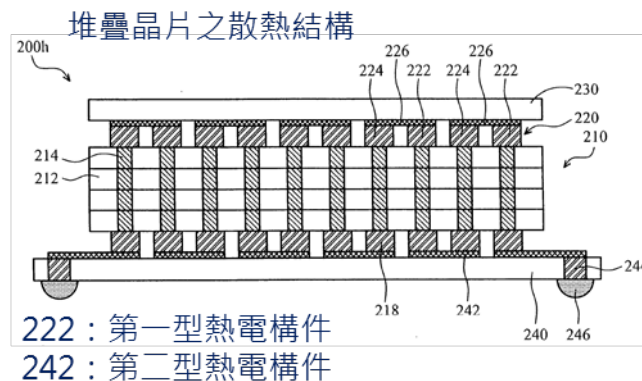
靜電放電保護裝置，包括一箝制電路、一偵測電路和一控制電路。箝制電路之第一端和第二端分別耦接一第一軌線和一第二軌線。回應於一靜電放電事件，箝制電路於其耦合端產生一第一耦合電位。偵測電路，耦接箝制電路之耦合端及第二軌線，其中回應該第一耦合電位，該偵測電路輸出一偵測信號。控制電路，耦接第一軌線、第二軌線、偵測電路 and 箝制電路，其中控制電路回應偵測信號而被致能時，輸出一導通信號至箝制電路之控制端，箝制電路回應導通信號而導通，使得第一軌線和第二軌線透過箝制電路作靜電放電。



■ 半導體構裝與熱電技術應用

P51980023 整合熱電元件與晶片的封裝體：

本發明提供一種整合熱電元件與晶片的封裝體，包括一晶片具有貫穿其中的電性導孔，一導電組件設置於該晶片的一側上與該對電性導孔電性接觸，一熱電元件設置於該晶片的另一側上，且對應於該導電組件，一載板設置於該熱電元件上。該載板具有一佈線，經該熱電元件、該對電性導孔及該導電組件形成一熱電流通路，將該晶片所產生的熱泵離。



附件二：專利清單

(一) 平面顯示器：5 案 9 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
1	1	P61990090US	顯示裝置	美國	獲證	US8736800	20140527	20321006	經濟部產業技術司	工研院; UCF	
	2	P61990090TW	顯示裝置	中華民國	獲證	TWI483047	20150501	20320612	經濟部產業技術司	工研院; UCF	
	3	P61990090CN	顯示裝置	中國大陸	獲證	CN102841472	20150520	20320612	經濟部產業技術司	工研院; UCF	
2	4	P61040016US	顯示裝置與光學膜	美國	獲證	US9680132	20170613	20351129	經濟部產業技術司	工研院; UCF	
3	5	P61030011TW	光學薄膜及顯示器裝置	中華民國	獲證	TWI561900	20161211	20350318	經濟部產業技術司	工研院; UCF	
4	6	P61010029US	顯示面板	美國	獲證	US9140937	20150922	20331229	工研院	工研院; UCF	
	7	P61010029TW	顯示面板	中華民國	獲證	TWI498651	20150901	20330619	工研院	工研院; UCF	
5	8	P61010007US	液晶顯示面板	美國	獲證	US9025120	20150505	20330829	工研院	工研院; UCF	
	9	P61010007TW	液晶顯示面板	中華民國	獲證	TWI485491	20150521	20330124	工研院	工研院; UCF	

(二) 系統晶片技術：4 案 8 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
6	10	P52990172US	混合模擬系統及方法	美國	獲證	US8645116	20140204	20320604	經濟部產業技術司	工研院	
	11	P52990172TW	混合模擬系統及方法	中華民國	獲證	TWI437390	20140511	20310106	經濟部產業技術司	工研院	
7	12	P52990114US	具電源管理之超長指令處理器及其電源管理裝置與方法	美國	獲證	US8769245	20140701	20330326	經濟部產業技術司	工研院	



案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
	13	P52990114TW	具電源管理之超長指令處理器及其電源管理裝置與方法	中華民國	獲證	TWI432953	20140401	20301208	經濟部產業技術司	工研院	
8	14	P52000091US	靜電放電保護裝置及其方法	美國	獲證	US8654492	20140218	20320405	經濟部產業技術司	工研院	
	15	P52000091TW	靜電放電保護裝置及其方法	中華民國	獲證	TWI463631	20141201	20311116	經濟部產業技術司	工研院	
9	16	P52000025US	可重新配置的指令編碼方法及處理器架構	美國	獲證	US9069548	20150630	20331208	經濟部產業技術司	工研院	
	17	P52000025TW	可重新配置的指令編碼方法及處理器架構	中華民國	獲證	TWI442317	20140621	20311106	經濟部產業技術司	工研院	

(三) 半導體構裝與熱電技術應用：2 案 5 件

案次	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	專利權人	契約運用
10	18	P51990054US	熱電轉換組件及其製造方法	美國	獲證	US8664509	20140304	20310921	經濟部產業技術司	工研院	
	19	P51990054TW	熱電轉換組件及其製造方法	中華民國	獲證	TWI443882	20140701	20301114	經濟部產業技術司	工研院	
11	20	P51980023US	整合熱電元件與晶片的封裝體	美國	獲證	US8546924	20131001	20310827	經濟部產業技術司	工研院	
	21	P51980023TW	整合熱電元件與晶片的封裝體	中華民國	獲證	TWI407545	20130901	20290818	經濟部產業技術司	工研院	
	22	P51980023CN	整合熱電組件與芯片的封裝體	中國大陸	獲證	CN102034805	20121226	20290923	經濟部產業技術司	工研院	

【備註】本讓與案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。